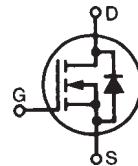


PolarHT™ Power MOSFET

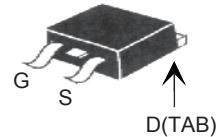
IXTA 36N30P
IXTP 36N30P
IXTQ 36N30P

V_{DSS} = 300 V
 I_{D25} = 36 A
 $R_{DS(on)}$ ≤ 110 mΩ

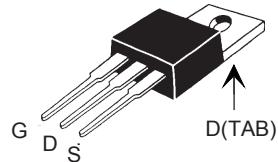
N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated



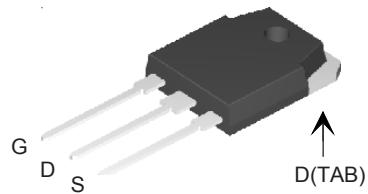
TO-263 (IXTA)



TO-220 (IXTP)



TO-3P (IXTQ)



G = Gate
S = Source

D = Drain
TAB = Drain

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings		
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	300	V	
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$; $R_{GS} = 1 M\Omega$	300	V	
V_{GS}	Continuous	± 30	V	
V_{GSM}	Transient	± 40	V	
I_{D25}	$T_c = 25^\circ C$	36	A	
I_{DM}	$T_c = 25^\circ C$, pulse width limited by T_{JM}	90	A	
I_{AR}	$T_c = 25^\circ C$	36	A	
E_{AR}	$T_c = 25^\circ C$	30	mJ	
E_{AS}	$T_c = 25^\circ C$	1.0	J	
dv/dt	$I_s \leq I_{DM}$, $di/dt \leq 100 A/\mu s$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$, $T_J \leq 150^\circ C$, $R_G = 10 \Omega$	10	V/ns	
P_D	$T_c = 25^\circ C$	300	W	
T_J		-55 ... +150	$^\circ C$	
T_{JM}		150	$^\circ C$	
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ C$	
T_L	1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s	300	$^\circ C$	
T_{SOOLD}	Plastic body for 10 s	260	$^\circ C$	
M_d	Mounting torque (TO-3P / TO-220)	1.13/10	Nm/lb.in.	
Weight	TO-3P TO-220 TO-263	5.5 4 3	g	

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ C$, unless otherwise specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{DSS}	$V_{GS} = 0 V$, $I_D = 250 \mu A$	300		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 250 \mu A$	3.0		5.5 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20 V_{DC}$, $V_{DS} = 0$		± 100	nA
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$ $V_{GS} = 0 V$		1 200	μA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10 V$, $I_D = 0.5 I_{D25}$ Pulse test, $t \leq 300 \mu s$, duty cycle $d \leq 2 \%$	92	110	mΩ

Features

- International standard packages
- Unclamped Inductive Switching (UIS) rated
- Low package inductance
 - easy to drive and to protect

Advantages

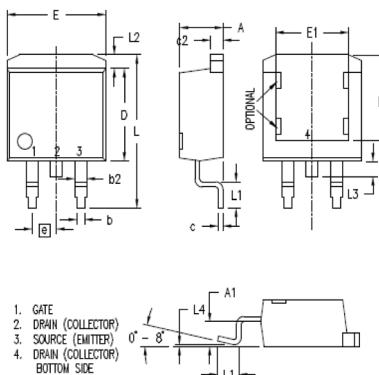
- Easy to mount
- Space savings
- High power density

Symbol Test Conditions
Characteristic Values
 $(T_J = 25^\circ C, \text{ unless otherwise specified})$
Min. Typ. Max.

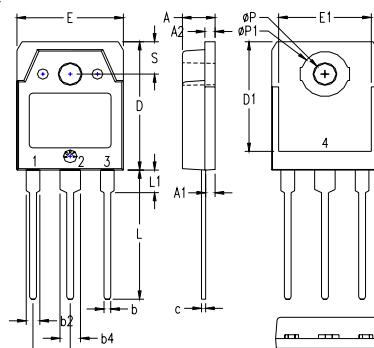
g_{fs}	$V_{DS} = 10 V; I_D = 0.5 I_{D25}$, pulse test	12	22	S
C_{iss}	$V_{GS} = 0 V, V_{DS} = 25 V, f = 1 \text{ MHz}$	2250	pF	
C_{oss}		370	pF	
C_{rss}		90	pF	
$t_{d(on)}$	$V_{GS} = 10 V, V_{DS} = 0.5 V_{DSS}, I_D = I_{D25}$ $R_G = 10 \Omega$ (External)	24	ns	
t_r		30	ns	
$t_{d(off)}$		97	ns	
t_f		28	ns	
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10 V, V_{DS} = 0.5 V_{DSS}, I_D = 0.5 I_{D25}$	70	nC	
Q_{gs}		17	nC	
Q_{gd}		35	nC	
R_{thJC}	(TO-3P) (TO-220)	0.21	0.42°C/W	
R_{thCS}				
		0.25	$^\circ \text{C/W}$	

Source-Drain Diode
Characteristic Values
 $(T_J = 25^\circ C, \text{ unless otherwise specified})$
Min. Typ. Max.

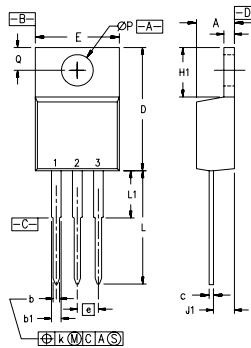
I_s	$V_{GS} = 0 V$		36	A
I_{SM}	Repetitive		90	A
V_{SD}	$I_F = I_s, V_{GS} = 0 V$, Pulse test, $t \leq 300 \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$		1.5	V
t_{rr}	$I_F = 25 A, -di/dt = 100 A/\mu\text{s}$	250	ns	
Q_{RM}	$V_R = 100 V, V_{GS} = 0 V$	2.0	μC	

TO-263 (IXTA) Outline


SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.160	.190	4.06	4.83
A1	.080	.110	2.03	2.79
b	.020	.039	0.51	0.99
b2	.045	.055	1.14	1.40
c	.016	.029	0.40	0.74
c2	.045	.055	1.14	1.40
D	.340	.380	8.64	9.65
D1	.315	.350	8.00	8.89
E	.380	.410	9.65	10.41
E1	.245	.320	6.22	8.13
e	.100	BSC	2.54	BSC
L	.575	.625	14.61	15.88
L1	.090	.110	2.29	2.79
L2	.040	.055	1.02	1.40
L3	.050	.070	1.27	1.78
L4	0	.005	0	0.13

TO-3P (IXTQ) Outline

1 - GATE
2 - DRAIN (COLLECTOR)
3 - SOURCE (EMITTER)
4 - DRAIN (COLLECTOR)

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.185	.193	4.70	4.90
A1	.051	.059	1.30	1.50
A2	.057	.065	1.45	1.65
b	.035	.045	0.90	1.15
b2	.075	.087	1.90	2.20
b4	.114	.126	2.90	3.20
c	.022	.031	0.55	0.80
D	.780	.799	19.80	20.30
D1	.665	.677	16.90	17.20
E	.610	.622	15.50	15.80
E1	.531	.539	13.50	13.70
e	.215	BSC	5.45	BSC
L	.779	.795	19.80	20.20
L1	.134	.142	3.40	3.60
$\emptyset P$.126	.134	3.20	3.40
$\emptyset P1$.272	.280	6.90	7.10
S	.193	.201	4.90	5.10

TO-220 (IXTP) Outline


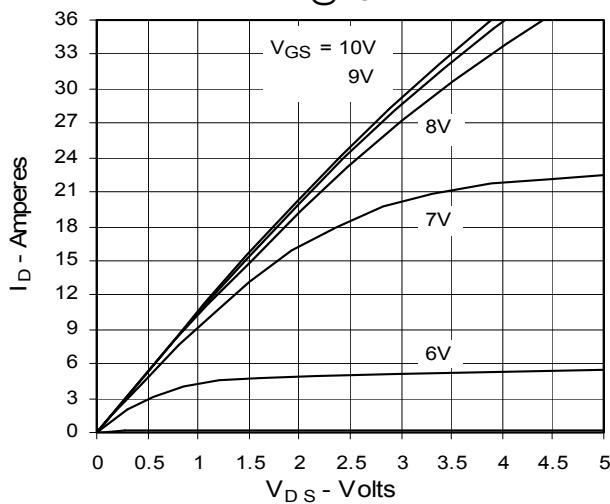
Pins: 1 - Gate 2 - Drain

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.170	.190	4.32	4.83
b	.025	.040	0.64	1.02
b1	.045	.065	1.15	1.65
c	.014	.022	0.35	0.56
D	.580	.630	14.73	16.00
E	.390	.420	9.91	10.66
e	.100	BSC	2.54	BSC
F	.045	.055	1.14	1.40
H1	.230	.270	5.85	6.85
J1	.090	.110	2.29	2.79
k	0	.015	0	0.38
L	.500	.550	12.70	13.97
L1	.110	.230	2.79	5.84
$\emptyset P$.139	.161	3.53	4.08
Q	.100	.125	2.54	3.18

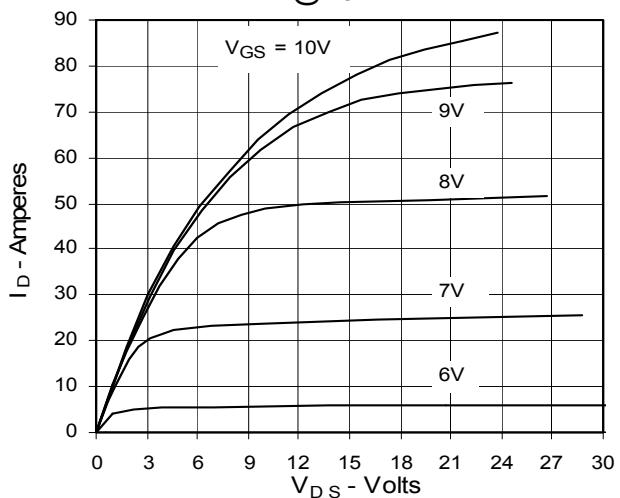
IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by 4,835,592 4,931,844 5,049,961 5,237,481 6,162,665 6,404,065 B1 6,683,344 6,727,585 one or more of the following U.S. patents: 4,850,072 5,017,508 5,063,307 5,381,025 6,259,123 B1 6,534,343 6,710,405B2 6,759,692 4,881,106 5,034,796 5,187,117 5,486,715 6,306,728 B1 6,583,505 6,710,463 6,771,478 B2

**Fig. 1. Output Characteristics
@ 25°C**



**Fig. 2. Extended Output Characteristics
@ 25°C**



**Fig. 3. Output Characteristics
@ 125°C**

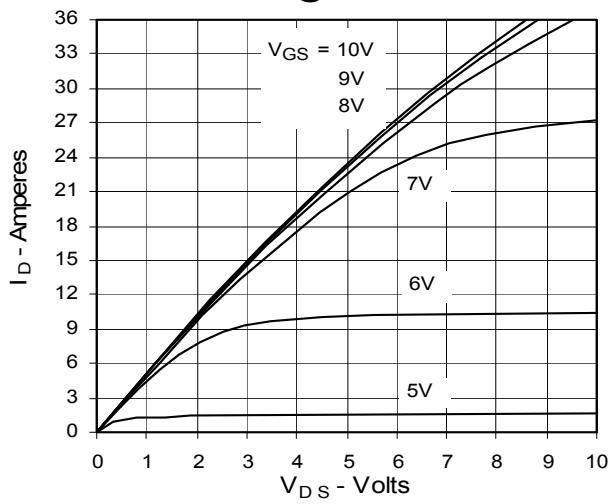


Fig. 4. $R_{DS(on)}$ Normalized to 0.5 I_{D25} Value vs. Junction Temperature

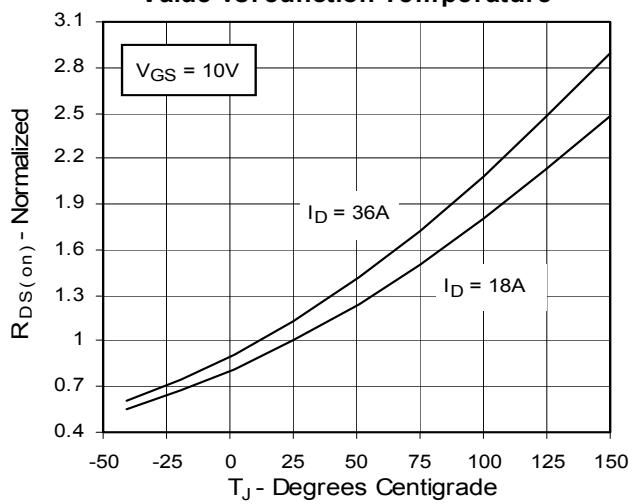


Fig. 5. $R_{DS(on)}$ Normalized to 0.5 I_{D25} Value vs. I_D

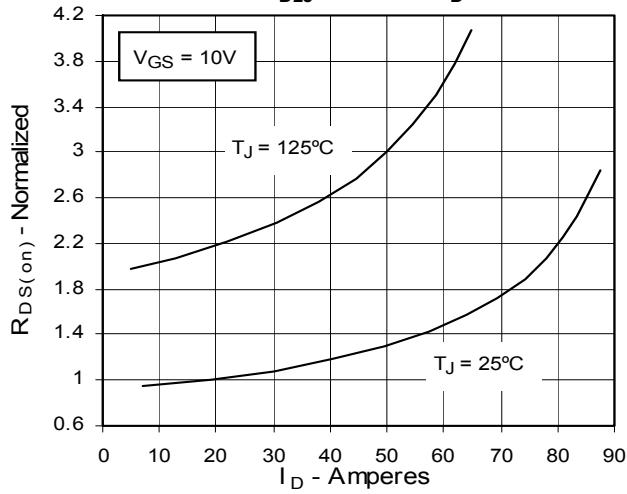


Fig. 6. Drain Current vs. Case Temperature

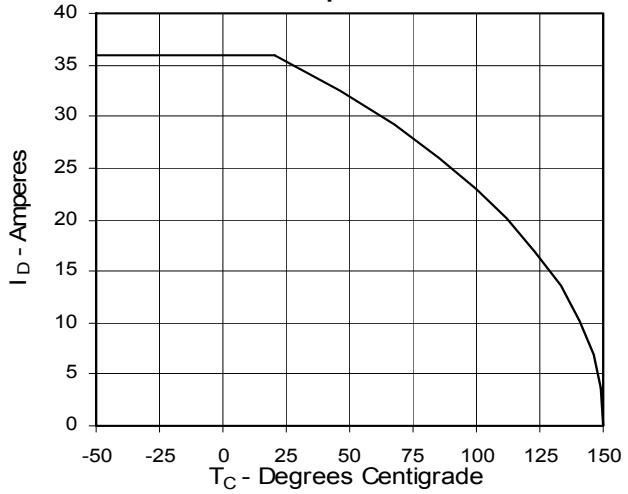


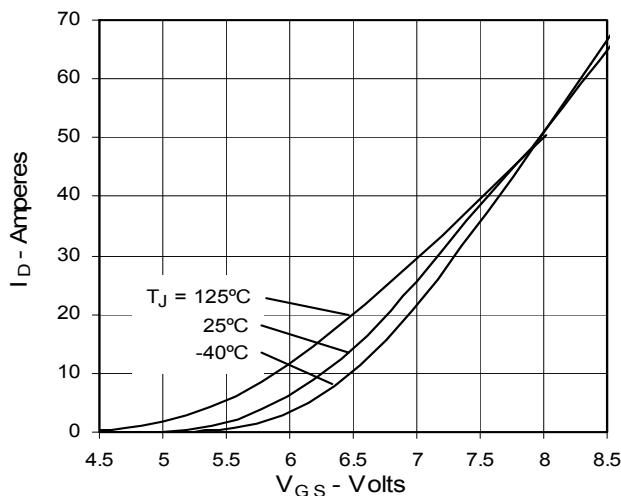
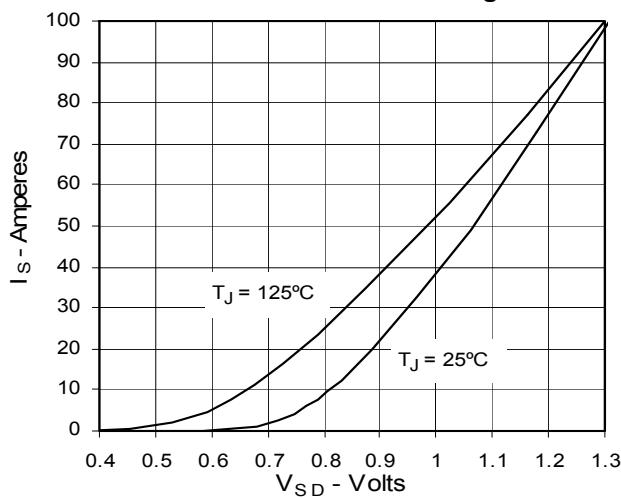
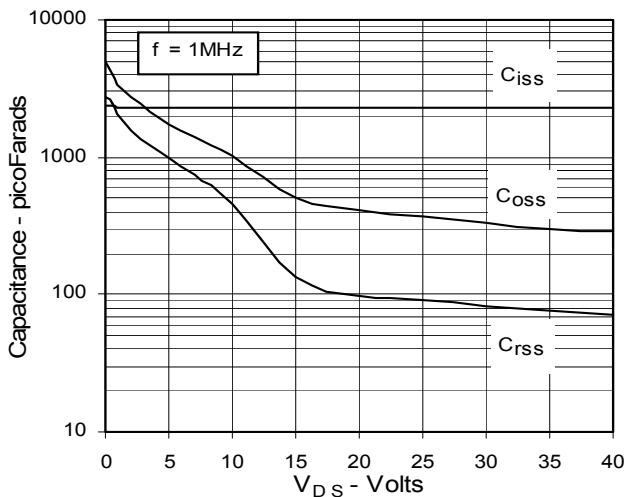
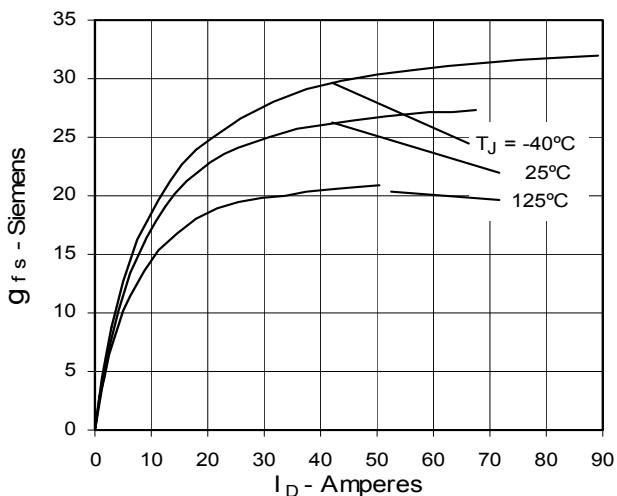
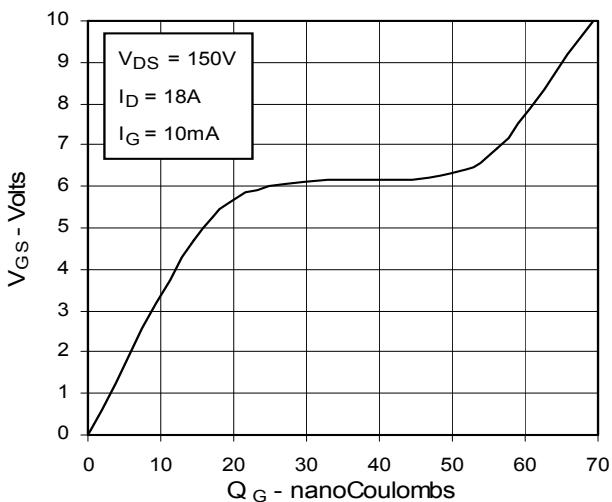
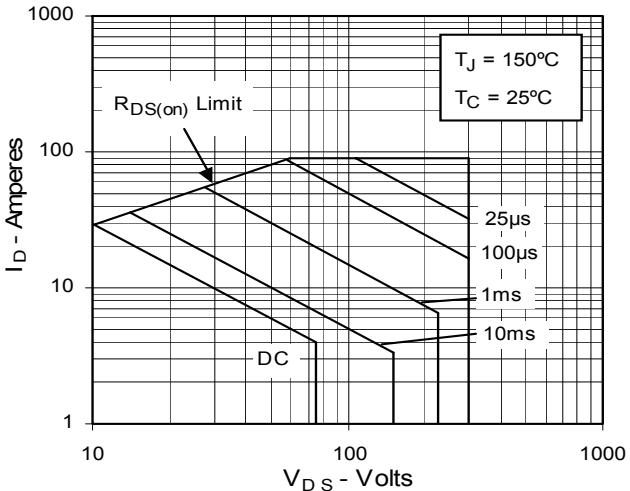
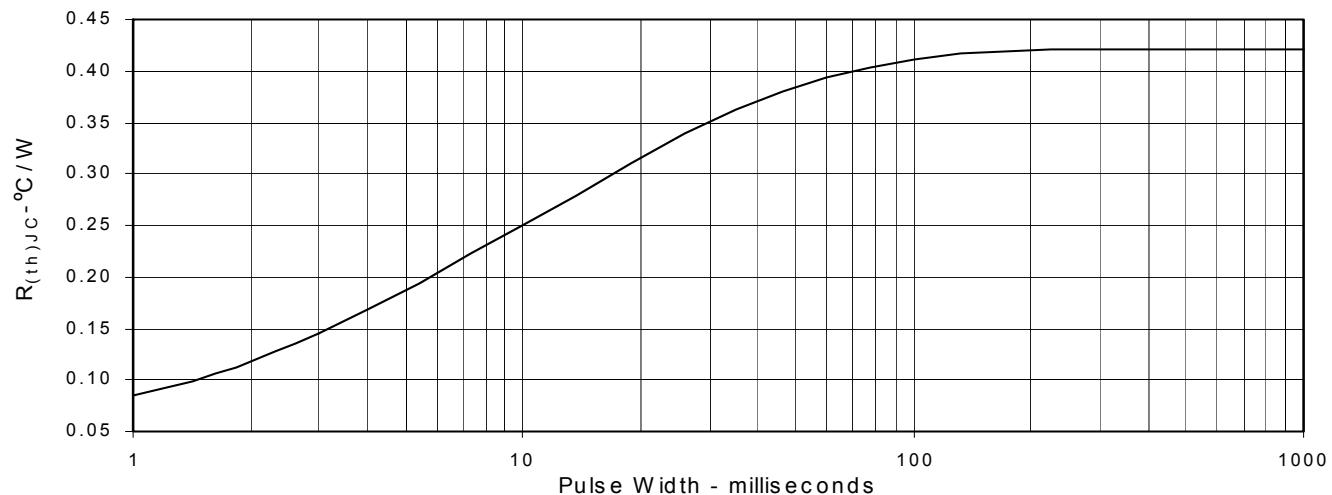
Fig. 7. Input Admittance

**Fig. 9. Source Current vs.
Source-To-Drain Voltage**

Fig. 11. Capacitance

Fig. 8. Transconductance

Fig. 10. Gate Charge

**Fig. 12. Forward-Bias
Safe Operating Area**


Fig. 13. Maximum Transient Thermal Resistance



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.